

2016日本パッケージングコンテスト入賞作品記念発表会 2016パッケージングフォーラム

—入賞3作品の商品開発事例発表—

開催日時：平成28年10月6日(木) 10:30～11:55

会 場：『TOKYO PACK2016(2016東京国際包装展)』

会場内 東6 - セミナーステージ1

主 催：公益社団法人日本包装技術協会

ご参加の勧め

先頃、公益社団法人日本包装技術協会主催により年1回開催している、日本パッケージングコンテストの審査会が行われ、415件にのぼる応募作品の中から、13件のジャパンスター賞並びに43件の包装技術賞、83件の包装部門賞と合わせて 139件の入賞作品が決定しました。

今回は、ジャパンスター賞に入賞された作品の中から、3作品につき商品開発事例等をご紹介します。どうぞ、この機会に関係各位お誘い併せの上、ご参加下さいますようにご案内申し上げます。

10:30～10:55

ジャパンスター賞

テ ー マ ラサーナ シャンプー・トリートメント詰め替えパック

発 表 者 株式会社 ヤマサキ 研究開発部 品質保証課 課長 山上 陽市郎 氏

発表内容 2011年に採用したカートリッジタイプの詰め替え商品。販売を開始すると、通信販売のお客様にはセット方法を正確に伝えることが難しく、「間違っってセットした」等のお声を頂くことが多くありました。改善をすすめる上で常に意識したことは「また詰め替えたい」とお客様に感じて頂ける商品作りでした。

11:00～11:25

ジャパンスター賞

テ ー マ 検品工程低減・RFIDタグを利用したリターナブルBox

発 表 者 株式会社 サンリツ 小川 紘央 氏

発表内容 製品返却時の検品工数低減と管理を簡単確実にできる環境負荷の少ないリターナブルBoxの開発を行った。BoxはダンボールBoxから簡単に折り畳み可能なリターナブルBoxへ変更、これにより、紙粉影響の心配もなくなった。更に、RFIDタグを実装することによりBoxの資産管理(トレーサビリティ)を可能とした。また、封函にはハンドカット可能な特殊タイラップを使用。色を使い分ける事により、返却工程における検品作業の低減を可能とした。

11:30～11:55

ジャパンスター賞

テ ー マ ワンタッチ組み立て Rakuppa Display

発 表 者 レンゴー株式会社 パッケージング部門 SP営業本部
SPデザインセンター 開発チーム 山本 麻依子 氏

発表内容 組み立て方が複雑で手間がかかるため店頭で設置されないフロアディスプレイが多かった。折りたたんだ状態からワンタッチで、しかも3秒で組み立てられる棚が3段の紙製汎用型フロアディスプレイを開発した。強度があるが軽量で持ち運びもラク。すぐに商品が並べられるため販売機会を逃さない。メーカーや小売店の販売促進へとつなげることをねらいとした。

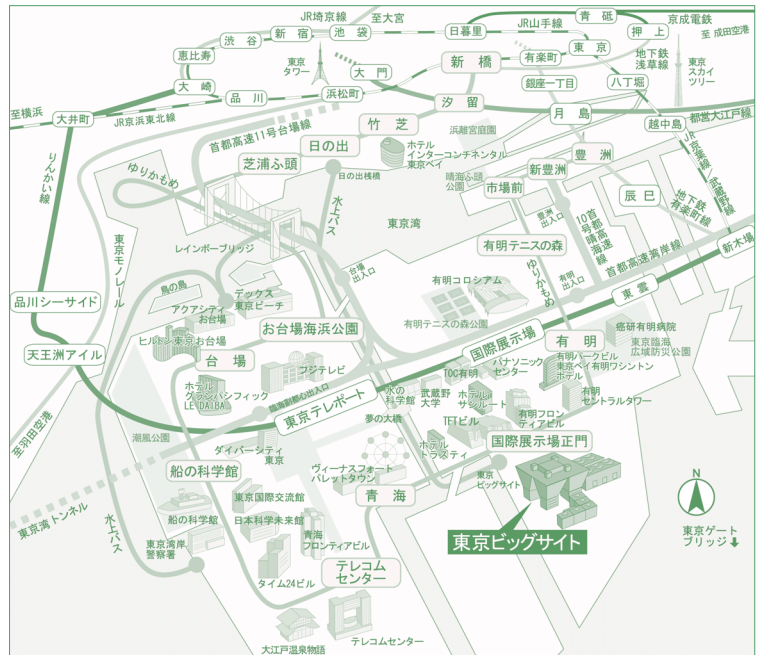
開催要領

- 名 称：2016パッケージングフォーラム
- 日 時：平成28年10月6日(木) 10:30～11:55
- 会 場：『TOKYO PACK2016(2016東京国際包装展)』
会場内 東一6セミナーステージ1
東京ビッグサイト
東京都江東区有明3-10-1(右記案内図参照)
- 定 員：200名
- 参 加 料：無料
- 同時開催：2016グッドパッケージング展
(『TOKYO PACK2016(2016東京国際包装展)』
会場特設コーナーにて)

交通経路

- りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
大崎駅(JR)から13分
新木場駅(JR、東京メトロ)から5分
※大崎から新宿・大宮方面へ、JR埼京線相互直通運転
渋谷(約20分)、新宿(約25分)、池袋(約31分)、
大宮(約56分)、川越(約78分)
- ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分
新橋駅(JR、東京メトロ、都営地下鉄)から22分
豊洲駅(東京メトロ)から8分

会場案内図



申込方法

本催しは、「東京パック2016」会場内特設会場での開催となります。その為、東京パックへの入場が必要となりますので、お申し込みの際は、専用ページより事前登録が必要となります。お手数ですが、下記URL (東京パックホームページ) よりお申し込みをお願いいたします。ご協力の程、宜しくお願い致します。

<http://www.tokyo-pack.jp/seminar/seminar07.html>

お問い合わせ

公益社団法人日本包装技術協会 パッケージングフォーラム係 担当：佐藤
〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル10F
TEL.03-3543-1189/FAX.03-3543-8970/email:satou@jpi.or.jp

個人情報の取り扱いについて

1. 個人情報は「2016パッケージングフォーラム」の事業実施に関わる資料等の作成、並びに当会が主催・実施する事業におけるサービスの提供や事業のご案内等のために利用させていただきます。なお、作成資料は、開催当日関係者に限り配布する場合があります。
2. 参加申し込みによりご提供いただいた個人情報は、法令に基づく場合などを除き第三者に開示・提供することはありません。